

技術運営委員会講演会「日本経済発展のためのエレクトロニクス実装技術」

	2月18日(木曜日)	2月19日(金曜日)
10:00	招待講演①	招待講演④ 「エレクトロニクス産業の将来を考える—ケイパビリティとアーキテクチャの観点から」 東京大学・藤本隆宏 氏
10:20	「ビッグデータと大規模通信の新時代を支えるのはやはり電子デバイスだ!!」	
10:40	～センサー、通信チップ、電子回路/実装が主役に躍り出る (株)産業タイムズ社・泉谷渉 氏	
11:00	招待講演② 「Industrie 4.0が必要とする実装技術」 インターコネクション・テクノロジーズ(株)・宇都宮久修 氏	配線板製造技術委員会 「プリント配線板とその製造技術の最新動向」 雀部技術事務所・雀部俊樹
11:20		部品内蔵技術委員会 「部品内蔵基板・評価・解析研究会の活動紹介」 福岡大学・加藤義尚
11:40		環境調和型実装技術委員会 「2016年のJIEP EcoDesign Tommorrow」 芝浦工業大学・林秀臣
12:00	パネルディスカッション 「ビッグデータで日本の製造は変わるか?」 司会:(株)ジェイデバイス・蛭田陽一 パネラー:泉谷渉 氏、宇都宮久修 氏 折井靖光 氏、土門孝彰 氏	昼食
12:20		
12:40		
13:00	昼食	ヘルスケアデバイス実装研究会とマイクロメカトロニクス実装技術委員会 「マイクロシステムを用いたヘルスケアデバイスの開発と将来展望」 東北大学・芳賀洋一
13:20		
13:40	招待講演③ 「The Direction of RDL Technology & Status of J-Devices' PLP Technology」 (株)ジェイデバイス・勝又章夫 氏	信頼性解技術委員会 「ECM研究会の活動状況(Air-HASTを中心として)」 日本規格協会・岡本秀孝
14:00		官能検査システム研究会 「官能検査システム化研究会の活動紹介」 産業技術総合研究所・野中一洋
14:20		材料技術委員会 「材料関連のトピックス(仮)」 横浜国立大学・高橋昭雄
14:40	電子部品・実装技術委員会 「電子部品および実装技術における今後の展望と課題」 (株)メイコー・戸田光昭	休憩
15:00	システムインテグレーション実装技術委員会 「将来の姿(システムトレンド)から見た実装技術の役割」 日本アイ・ビー・エム・折井靖光	カーエレクトロニクス研究会 「カーエレクトロニクス実装の動向と展望」 (株)デンソー・三宅敏広
15:20	休憩	パワーエレクトロニクス研究会 「パワエレ研究会における実装技術の展望と現状」 富士電機(株)・西村芳孝
15:40	検査技術委員会 「検査技術領域の課題の共有(仮)」 富士ゼロックス(株)・内山浩志	サーマルマネジメント研究会 「サーマルマネジメントの最新動向」 富山県立大学・畠山友行
16:00	回路・実装設計技術委員会 「研究会活動の概要, システム実装設計技術, およびシミュレーション技術」 群馬大学・白石洋一、富士通アドバンステクノロジー(株)・除村均	光回路実装技術委員会 「光回路実装技術ロードマップ策定に関する活動状況」 (株)日立製作所・松岡康信
16:20	電磁特性技術委員会 「電磁特性技術委員会、及び傘下研究会の活動紹介」 (株)東芝 井関裕二	クロージング
16:40	評価規格化検討委員会 「評価規格化委員会、及び最近の規格化、標準化トピックスの紹介」 日本電気(株)・井上博文	